

## 日月光一〇二年度第四季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 103 年 2 月 7 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇二年度第四季及全年獲利報告，本公司一〇二年第四季之合併營業收入較一〇二年第三季成長 13%，較一〇一年同期成長 15%，為新台幣 64,164 百萬元。一〇二年全年之合併營業收入較一〇一年全年成長 13%，為新台幣 219,862 百萬元。茲將日月光一〇二年度第四季單季及全年之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

簡明日月光集團合併營運分析表

單位：新台幣百萬元

| 項 目              | 102 年度<br>第四季 | 102 年度<br>第三季 | 101 年度<br>第四季 | 102 年度<br>全年 | 101 年度<br>全年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 營業收入             | 64,164        | 56,748        | 56,008        | 219,862      | 193,972      |
| 營業毛利             | 12,486        | 11,587        | 10,976        | 42,790       | 36,620       |
| 營業淨利(淨損)         | 6,873         | 6,099         | 5,934         | 21,978       | 17,687       |
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損)   | 6,456         | 5,368         | 5,815         | 20,021       | 16,584       |
| 所得稅利益(費用)        | (507)         | (822)         | (1,288)       | (3,259)      | (3,061)      |
| 非控制權益純損(益)       | (134)         | (116)         | (154)         | (466)        | (457)        |
| 本期歸屬予母公司股東淨利(淨損) | 5,815         | 4,430         | 4,373         | 16,296       | 13,066       |
| 稀釋每股盈餘(元)        | 0.73          | 0.57          | 0.58          | 2.11         | 1.71         |

簡明日月光半導體封裝測試營運分析表

單位：新台幣百萬元

| 項 目              | 102 年度<br>第四季 | 102 年度<br>第三季 | 101 年度<br>第四季 | 102 年度<br>全年 | 101 年度<br>全年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 營業收入             | 37,900        | 37,810        | 34,396        | 143,322      | 130,008      |
| 營業毛利             | 10,425        | 9,646         | 7,972         | 35,018       | 28,550       |
| 營業淨利(淨損)         | 6,083         | 5,383         | 4,197         | 18,945       | 14,198       |
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損)   | 6,319         | 5,134         | 4,973         | 19,062       | 15,123       |
| 所得稅利益(費用)        | (463)         | (661)         | (556)         | (2,605)      | (1,926)      |
| 非控制權益純損(益)       | (41)          | (43)          | (44)          | (161)        | (131)        |
| 本期歸屬予母公司股東淨利(淨損) | 5,815         | 4,430         | 4,373         | 16,296       | 13,066       |
| 稀釋每股盈餘(元)        | 0.73          | 0.57          | 0.58          | 2.11         | 1.71         |

### 半導體封裝測試營運

| 產 品 結 構    | 占營收比率(%) |
|------------|----------|
| 通訊產品       | 57       |
| 個人電腦       | 10       |
| 汽車及消費性電子產品 | 33       |
| 其他         | 0        |
| 前十大客戶佔營收比重 | 52       |

| 銷 售 地 區 | 占營收比率(%) |
|---------|----------|
| 北美      | 63       |
| 歐洲      | 10       |
| 台灣      | 16       |
| 日本      | 6        |
| 亞洲其他地區  | 5        |

| 封 裝 業 務 產 品 組 合     | 占營收比率(%) |
|---------------------|----------|
| Advanced Packaging  | 33       |
| IC Wirebonding      | 57       |
| Discrete and Others | 10       |
| 封裝資本支出金額            | 46 百萬美元  |
| 打線機台數               | 15,692 台 |

| 測 試 業 務 產 品 組 合 | 占營收比率(%) |
|-----------------|----------|
| 後段測試            | 77       |
| 晶圓測試            | 21       |
| 前段測試            | 2        |
| 測試資本支出金額        | 17 百萬美元  |
| 測試機台數           | 3,117 台  |

### 電子製造代工服務之產品結構及客戶組成

| 產 品 結 構    | 占營收比率(%) |
|------------|----------|
| 通訊產品       | 61       |
| 電腦產品       | 16       |
| 消費產品       | 8        |
| 工業產品       | 9        |
| 汽車電子產品     | 5        |
| 其他         | 1        |
| 前十大客戶佔營收比重 | 90       |
| EMS 資本支出金額 | 12 百萬美元  |

根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光公司 2014 年第一季的業績展望如下：

- 半導體封裝測試材料營收將下滑約 12% 至 15%，電子製造代工服務營收將依季節性因素下滑約 30%；
- 合併營業毛利率預計介於 17% 到 18% 之間；
- 全年在設備方面的資本支出約美金 7 億元，並根據市場狀況調整。